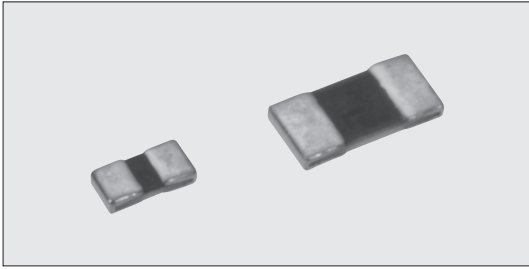
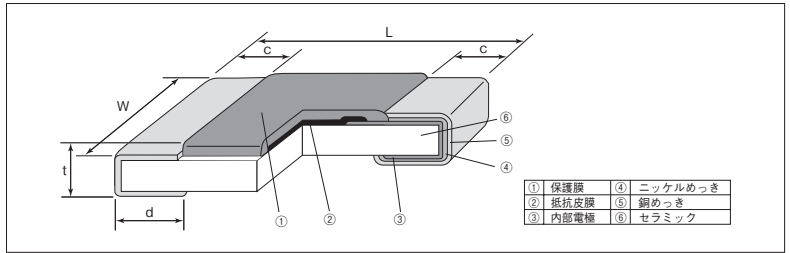


XR73B・XR73H・XR73Z ■ 基板内蔵用チップ抵抗器



外表色：黒

■ 構造図



■ 特長

- 低背0.13~0.14mm (代表値) により、多層配線基板への層間内蔵が可能です。
- Cu電極によりCuビア接続に対応します。

■ 用途

- 通信モジュール、半導体パッケージ用基板。
- スマートフォン、タブレットPC、ノートPC、ウェアラブルデバイス等。

■ 参考規格

IEC 60115-8
JIS C 5201-8
EIAJ RC-2134A

■ 外形寸法

形名 (mmサイズコード)	寸法 (mm)					質量 (g) (1000pcs)
	L	W	c	d	t	
1H (0603)	0.6±0.03	0.3±0.03	0.23±0.03	0.23±0.03	0.13±0.02	0.11
1E (1005)	1.0±0.05	0.5±0.05	0.28±0.05	0.28±0.05	0.14±0.03	0.26

■ 品名構成

例

XR73H	1E	U	TWL	103	F
品 種	定格電力	端子表面材質	二次加工	公称抵抗値	抵抗値許容差
XR73B XR73H	1H : 0.063W 1E : 0.063W	U : Cu	TWL:エンボステープ (2mmピッチ) TWA:エンボステープ (1mmピッチ) BK:バルク	F: 4桁 J: 3桁	F: ±1% J: ±5%

XR73Z	1E	U	TWL
品 種	定格電流	端子表面材質	二次加工
XR73Z	1H : 1A 1E : 1A	U : Cu	TWL:エンボステープ (2mmピッチ) TWA:エンボステープ (1mmピッチ) BK:バルク

環境負荷物質含有についてEU-RoHS以外の物質に対するご要望がある場合にはお問い合わせ下さい。
テーピングのTWA仕様は1Hのみとなります。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照してください。

■ 定格

XR73B, XR73H

形 名	定格電力 ^{※1}	定格周囲温度	抵抗温度係数 (×10 ⁻⁶ /K)	抵抗値範囲 (Ω)		最高使用電圧	最高過負荷電圧	二次加工と包装数/リール (pcs)	
				XR73H F: ±1% E24・E96	XR73B J: ±5% E24			TWL	TWA
1H	0.063W	70°C	±200	10~1M	50V	100V	20,000	40,000	
			±400	1.0~9.1 ^{※2}					
1E	0.063W		±100	10~1M	50V	100V	20,000	—	
			±200	1.0~9.76 1.02M~10M					

使用温度範囲: -55°C ~ +155°C

定格電圧は√定格電力×公称抵抗値による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。

※1 表面実装状態での定格となります。

※2 XR73H1H (1Ω ≤ R ≤ 9.1Ω) の公称抵抗値はE-24となります。

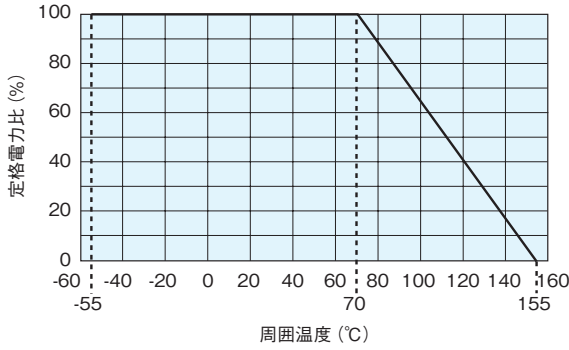
XR73Z

形 名	抵抗値	定格電流 [*]	定格周囲温度	最高過負荷電流	二次加工と包装数/リール (pcs)	
					TWL	TWA
1H	50mΩ以下	1A	70°C	2A	20,000	40,000
1E		1A			20,000	—

使用温度範囲: -55°C ~ +155°C

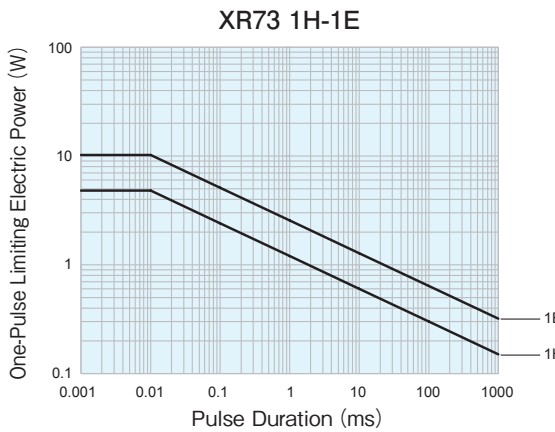
※表面実装状態での定格となります。

■ 負荷軽減曲線



周囲温度70℃以上で使用される場合は、左図負荷軽減曲線に従って、電力を軽減してご使用ください。

■ ワンパルス限界電力曲線



印加可能な電圧の上限は最高過負荷電圧になります。
パルスを連続して印加する場合の耐性はお問い合わせください。
本データは参考値ですので、ご使用の際は必ず実機での確認をしてください。

■ 性能*

試験項目	XR73H, XR73B		XR73Z		試験方法
	規格値 ΔR± (%+0.05Ω)		規格値		
	保証値	代表値	保証値	代表値	
抵抗値	規定の許容差内	—	50mΩ以下	15mΩ以下	25°C
抵抗温度係数	規定値内	—	—	—	+25°C / -55°C、+25°C / +125°C
過負荷 (短時間)	2	0.5	50mΩ以下	R ≤ 20mΩ : 1E R ≤ 40mΩ : 1H	定格電圧 (DC) × 2.5倍を5秒印加 (1Hは定格電圧 (DC) × 2倍)
温度急変	1	0.5	100mΩ以下	R ≤ 20mΩ : 1E R ≤ 40mΩ : 1H	-55°C (30min.) / +125°C (30min.) 100 cycles
耐湿負荷	3	1.5	100mΩ以下	R ≤ 20mΩ : 1E R ≤ 40mΩ : 1H	40°C ± 2°C、90%~95%RH、1000h 1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期
70°Cでの耐久性	3	1	100mΩ以下	R ≤ 20mΩ : 1E R ≤ 40mΩ : 1H	70°C ± 2°C、1000h 1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期
高温放置	1	0.5	100mΩ以下	R ≤ 20mΩ : 1E R ≤ 40mΩ : 1H	+155°C、1000h

* 表面実装状態での性能となります。

■ 使用上の注意

- 本製品は、基板内蔵用としてCuめっきにて接続する事を想定しております。接続については事前にご評価の上ご使用ください。
- 汎用品と比較して薄いチップとなっているため、実装条件 (ノズル形状、押し込み量、実装速度など) を適正にし、ご使用ください。
- 基板の材質・配線パターン等によって放熱状態が変わるため、内蔵状態にて評価の上ご使用ください。